

行业点评

华虹一季度业绩符合预期，整体产能利用率维持满产

强于大市（维持）

行情走势图



证券分析师

付强 投资咨询资格编号
S1060520070001
FUQIANG021@pingan.com.cn

徐勇 投资咨询资格编号
S1060519090004
XUYONG318@pingan.com.cn

研究助理

徐碧云 一般证券从业资格编号
S1060121070070
XUBIYUN372@pingan.com.cn



事项：

华虹半导体发布2023年一季报，公司2023年第一季度单季度实现营业收入6.308亿美元，同比增长6.1%；实现归母净利润1.522亿美元，同比增长47.9%。

平安观点：

- **一季度业绩符合预期，产能利用率基本稳住且满载：**公司一季度单季度营收为6.31亿美元，同比增长6.1%，环比持平，与上季度的指引一致，主要是通过调整产品组合以及销售策略，使产能利用率保持高位运行；归母净利润为1.52亿美元，同比增长47.9%，环比下降4.3%；毛利率为32.1%，处于此前的指引区间偏下限（32%-34%），同比上升5.2pct，环比下降6.1pct，主要是平均销售单价上涨，但部分被折旧成本上升所抵消；净利润率达到了22.3%，同比提升5.1pct，环比下降7.2pct；整体的产能利用率为103.5%，维持满产，但同比下降2.5pct，环比提升0.3pct；交付晶圆（折合8吋）1001K片，同比下降5.3%，环比提升0.9%；资本开支2.166亿美元，其中1.91亿美元用于无锡12吋厂。分8吋和12吋来看，8吋厂实现营收3.796亿美元（+14.1%YoY），营收占比为60.2%，产能利用率达107.1%（-0.6pct YoY，+1.2pct QoQ）；12吋厂实现营收2.513亿美元（-4.1%YoY），营收占比为39.8%，产能利用率达99%（-4.9pct YoY，-0.9pct QoQ）。
- **MCU、IGBT和超级结需求较好，工业与汽车业务保持高增长态势：**从技术平台来看，2023年Q1，嵌入式非易失性存储器、独立式非易失性存储器、分立器件、逻辑及射频、模拟与电源管理营收占比分别为37.9%、5.0%、36.9%、6.2%、13.9%，其中独立式非易失性存储器、逻辑与射频、模拟与电源管理营收同比下滑，而营收占比最大的嵌入式非易失性存储器和分立器件营收分别同比增长68.2%（主要得益于MCU及智能卡芯片的需求增加）和28.3%（主要得益于IGBT及超级结的需求增加）。从工艺技术节点来看，55nm及65nm、90nm及95nm、0.11μm及0.13μm、0.15μm及0.18μm、0.25μm、0.35μm及以上营收占比分别为9.2%、18.9%、20.4%、7.0%、0.7%、43.8%。其中55nm及65nm营收同比下降了43.2%，主要是NOR Flash、逻辑及CIS的需求减少；而0.11μm及0.13μm制程营收同比增长了55.6%，主要是MCU的需求增加。从地区来看，中国、北美、亚洲、欧洲、日本的销售收入占比分别为75.7%、11.2%、6.2%、5.9%、1.0%。从终端市场来看，分为电子消费品（58.4%）、工业与汽车（28.6%）、通讯（10.0%）、计算机（3.0%），其中第一大市场消费电子同比下降6.7%，主要是电源管理、NOR Flash、逻辑产品需求减少，部分抵消了MCU、超级结的需求增加；通讯同比下降13.8%，主要是CIS需求减少，抵消了智能卡芯片的需求。

求增加；而工业与汽车继续保持了同比增长69.8%的态势，主要是MCU、IGBT、MOSFET需求增加。业绩指引方面，公司预计2023年Q2营收仍保持在6.30亿美元，毛利率预计继续降至25%~27%，一方面是受到NOR Flash、CIS等需求下滑的影响，另一方面来源于12吋产能扩张带来的折旧费用增加。公司当前12吋厂的产出在6.8~7万片/月，将在年内达到9.5万片/月。5月10日，公司发布公告，将于5月17日科创板首发上会，其中华虹制造（无锡）项目125亿元、8英寸厂优化升级项目20亿元、特色工艺技术创新研发项目25亿元。这将有助于华虹进一步扩大产能规模，保持在特色工艺平台技术领域的领先地位。

- **投资建议：**华虹半导体作为全球领先的特色工艺晶圆代工厂，在特色IC和功率器件领域持续深耕，重点发力汽车和工业市场。从公司的业绩发布会看到，半导体市场继续在分化，当前芯片低迷状态尚未改善，库存仍在消化中，下游消费电子、通讯、计算机市场需求依然疲软，而汽车、工业等市场的MCU、智能卡、IGBT和超级结需求较好，建议关注相关赛道和业务已经取得突破的公司。IGBT、超级结方面，推荐时代电气、斯达半导，建议关注东微半导；MCU方面，推荐兆易创新。
- **风险提示：**1) 宏观经济波动和行业周期性的风险：如果宏观经济波动较大或长期处于低谷，消费电子等下游市场需求的波动和低迷亦会导致半导体产品的需求下降，半导体上市公司收入和业绩增长可能不及预期。2) 国际贸易摩擦的风险上升。中美关系的不确定性较高，美国对中国科技产业的打压加剧，半导体产业对全球尤其是美国科技产业链的依赖依然严重，被“卡脖子”的风险依然较高。3) 政策支持力度不及预期。半导体产业正处在发展的关键时期，很多领域在国内处于起步阶段，离不开政府政策的引导和扶持，如果后续政策落地不及预期，行业发展可能面临困难。4) 国产替代不及预期。如果客户认证周期过长，国内厂商的产品研发技术水平达不到要求，则可能影响国产替代的进程。

平安证券研究所投资评级:

股票投资评级:

强烈推荐（预计6个月内，股价表现强于市场表现20%以上）

推荐（预计6个月内，股价表现强于市场表现10%至20%之间）

中性（预计6个月内，股价表现相对市场表现在±10%之间）

回避（预计6个月内，股价表现弱于市场表现10%以上）

行业投资评级:

强于大市（预计6个月内，行业指数表现强于市场表现5%以上）

中性（预计6个月内，行业指数表现相对市场表现在±5%之间）

弱于大市（预计6个月内，行业指数表现弱于市场表现5%以上）

公司声明及风险提示:

负责撰写此报告的分析师(一人或多人)就本研究报告确认:本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格。

平安证券股份有限公司具备证券投资咨询业务资格。本公司研究报告是针对与公司签署服务协议的签约客户的专属研究产品，为该类客户进行投资决策时提供辅助和参考，双方对权利与义务均有严格约定。本公司研究报告仅提供给上述特定客户，并不面向公众发布。未经书面授权刊载或者转发的，本公司将采取维权措施追究其侵权责任。

证券市场是一个风险无时不在的市场。您在进行证券交易时存在赢利的可能，也存在亏损的风险。请您务必对此有清醒的认识，认真考虑是否进行证券交易。

市场有风险，投资需谨慎。

免责条款:

此报告旨在发给平安证券股份有限公司(以下简称“平安证券”)的特定客户及其他专业人士。未经平安证券事先书面明文批准，不得更改或以任何方式传送、复印或派发此报告的材料、内容及其复印本予任何其他人。

此报告所载资料的来源及观点的出处皆被平安证券认为可靠，但平安证券不能担保其准确性或完整性，报告中的信息或所表达观点不构成所述证券买卖的出价或询价，报告内容仅供参考。平安证券不对因使用此报告的材料而引致的损失而负上任何责任，除非法律法规有明确规定。客户并不能仅依靠此报告而取代行使独立判断。

平安证券可发出其它与本报告所载资料不一致及有不同结论的报告。本报告及该等报告反映编写分析员的不同设想、见解及分析方法。报告所载资料、意见及推测仅反映分析员于发出此报告日期当日的判断，可随时更改。此报告所指的证券价格、价值及收入可跌可升。为免生疑问，此报告所载观点并不代表平安证券的立场。

平安证券在法律许可的情况下可能参与此报告所提及的发行商的投资银行业务或投资其发行的证券。

平安证券股份有限公司2023版权所有。保留一切权利。

平安证券

平安证券研究所

电话:4008866338

深圳

深圳市福田区益田路5023号平安金融中心B座25层

上海

上海市陆家嘴环路1333号平安金融大厦26楼

北京

北京市丰台区金泽西路4号院1号楼丽泽平安金融中心B座25层